

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年8月26日(2010.8.26)

【公開番号】特開2009-10192(P2009-10192A)

【公開日】平成21年1月15日(2009.1.15)

【年通号数】公開・登録公報2009-002

【出願番号】特願2007-170561(P2007-170561)

【国際特許分類】

H 01 L	25/07	(2006.01)
H 01 L	25/18	(2006.01)
H 05 K	1/02	(2006.01)
H 05 K	1/05	(2006.01)
H 01 L	23/12	(2006.01)

【F I】

H 01 L	25/04	C
H 05 K	1/02	J
H 05 K	1/05	Z
H 01 L	23/12	Z

【手続補正書】

【提出日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

凹部が形成された金属基板と、
前記金属基板の上に設けられた絶縁層と、
前記凹部の上方に位置する前記絶縁層に埋め込まれ、高電圧の信号が伝送される複数の
第1の配線と、
前記絶縁層の上方に設けられた第2の配線に接続された回路素子と、
を備えることを特徴とする回路装置。

【請求項2】

前記複数の配線の間隔をH(mm)とし、空気の絶縁耐圧をW(V/mm)とし、前記第1の配線
の電圧をP(V)としたときに、
H < P / W

なる関係が成立していることを特徴とする請求項1に記載の回路装置。

【請求項3】

前記回路素子が、前記凹部以外の上方に位置する絶縁層の上方に設けられた第2の配線
上に設けられていることを特徴とする請求項1または2に記載の回路装置。

【請求項4】

前記第1の配線の前記金属基板側の表面は、前記第2の配線の前記金属基板側の表面よ
りも、前記凹部の深さ分だけ前記金属基板側に近い位置に配置されていることを特徴とす
る請求項1乃至3のいずれか1項に記載の回路装置。

【請求項5】

前記第1の配線に印加される電圧は、前記第2の配線に印加される電圧よりも高いこと
を特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の回路装置。

【請求項 6】

前記回路素子がインバータ用のパワー素子であることを特徴とする請求項 1 乃至5 のいずれか 1 項に記載の回路装置。